

# LCP 日本新石油化学HM-302连接器专用LCP塑胶原料欢迎来电

产品名称	LCP 日本新石油化学HM-302连接器专用LCP塑胶原料欢迎来电
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶原料 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

## 产品详情

流道和浇口可以使用任何类型的浇口。如果使用潜水口，则最好使用较短的类型。对于均聚物材料建议使用热注嘴流道。对于共聚物材料既可使用内部的热流道也可使用外部热流道。

塑胶原料按照合成树脂的分子结构分主要有热塑性及热固性塑胶之分：对于热塑性塑胶指反复加热仍有可塑性的塑胶：主要有PE/PP/PVC/PS/ABS/PMMA/POM/PC/PA等常用原料。热固性塑胶主要指加热硬化的合成树脂制得的得塑胶，像一些酚醛塑胶及氨基塑胶。

聚合物:指聚合过程所产生的纯材料或称聚合材料。无论天然树脂还是合成树脂均属高分子合聚物，简称高聚物。

COC具有与PMMA相匹敌的光学性能以及具有高于PC的耐热性,还具有比PMMA和PC更加优良的尺寸稳定性等.COC还具有改善水蒸汽气密性,增加刚性耐热性,易赋予切割性能等优点.

LCP液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变缺点，液晶材料可忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。

POM（又称赛钢、特灵）。它是以甲醛等为原料聚合所得。POM-H（聚甲醛均聚物），POM-K（聚甲醛共聚物）是高密度、高结晶度的热塑性工程塑料。具有良好的物理、机械和化学性能，尤其是有的性能。POM属结晶性塑料，熔点明显，一旦达到熔点，熔体粘度迅速下降。当温度超过一定限度或熔体受热时间过长，会引起分解。铜是POM降解催化剂，与POM熔体接触的部位应避免使用铜或铜材料。

阻隔性能好 塑料对气体和水蒸气有极好的阻隔性，因此，可以用塑料制品各种容器、制品和薄膜，可起到很好的防水、防潮作用。

POM的熔体粘度对剪切速率敏感。因此，要提高熔体流动性，不能单用提高温度，也要从提高注射速率和注射压力着手。大浇口、厚壁短流程、小面积的制品，注射压力为40~80MPa；一般制品为100MPa

左右。小浇口、薄壁长流程、大面积的制品，注射压力较高，为120~140MPa。

它是一种新型的高分子材料，在熔融态时一般呈现液晶性。这类材料具有优异的耐热性能和成型加工性能。

不过相对应的，使用这类材质制作连接器产品的价格会更高，因为本身材料价格就昂贵，另外还需要汽车连接器产品厂家的工艺相配合，所以使用这种材料的一般是特殊客户才有此要求的。

6T塑胶材料连接器厂家表示，这种材料一般是用在2.54间距贴片排母，和1.27间距/2.0间距系列排母上。耐焊接温度在260度-290度之间，所以使用这种材料生产的排母连接器成本略高，选择这种材料一般是客户在产品上有质量的要求。

模具温度通常控制在80~100℃，对薄壁长流程

工业领域：由于具有良好机械性能、耐高温、耐磨耗，并能耐高压，常用来制造压缩机阀片、活塞环、密封件等。

尼龙-66。一种热塑性树脂，白色固体，密度1.14，熔点253℃，不溶于一般溶剂，仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高，刚性很大，可用作工程塑料。洛氏硬度108-118，热变形温度（1814.11帕，18.5公斤力/厘米<sup>2</sup>）66-86℃。用作机械附件，如齿轮、润滑轴承；代替有色金属材料做机器外壳，汽车发动机叶片等。也可用于制合成纤维。

LCP塑胶原料的特性；

- a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300℃，其电性能不受影响。间断使用温度可达316℃左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。
- b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。